Verfahren zur Herstellung eines Si_3N_4 beschichteten SiO_2 Formkörpers

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Si_3N_4 beschichteten SiO_2 -Formkörpers.

Poröse, offenporige, amorphe SiO₂-Formkörper werden auf vielen technischen Gebieten benutzt. Als Beispiele seien Filtermaterialien, Wärmedämmmaterialien oder Hitzeschilder genannt. Ferner werden poröse, offenporige, amorphe SiO₂-Formkörper in rechteckiger Form zum Kristallisieren von Silicium bei der Herstellung von polykristallinen Solarsiliciumblöcken verwendet. Diese rechteckigen Tiegel werden im Folgenden als Solartiegel bezeichnet.

15

20

10

Wird flüssiges Silicium durch langsames Abkühlen in den Solartiegeln kristallisiert, schrumpft es stärker als der Solartiegel aus SiO_2 . Da sich das Silicium sehr fest mit der Tiegelinnenseite verbindet, kommt es zu Rissen im polykristallinen Siliciumblock. Da dies unter allen Umständen vermieden werden muss, werden alle Solartiegel innenseitig mit einer Si_3N_4 -Schicht versehen, die ein Anhaften des Siliciums am Tiegel verhindert.

Die porösen, offenporigen, amorphen Solartiegel werden im Allgemeinen über ein keramisches Schlickergussverfahren hergestellt. Dabei werden SiO₂-Partikel in Wasser dispergiert, z. B.
mittels eines Druckgussverfahrens geformt, anschließend getrocknet und mittels einer Wärmebehandlung (Sinterung) verfestigt (angesintert). In einem zweiten Schritt wird die Si₃N₄Schicht innenseitig aufgebracht. Stand der Technik ist hier die
Verwendung von Si₃N₄-Pulver, das über ein Plasmaverfahren (sog.
Plasmaspritzen) auf die Tiegeloberfläche aufgetragen wird und

dort die Si₃N₄-Schicht bildet.

35

Um einen möglichst hohen Wirkungsgrad des Solarsiliciums zu erreichen, ist es äußerst wichtig, das hochreine Silicium während der Kristallisation nicht mit Metallen zu verunreinigen. Daher

2

muss sowohl der Solartiegel, als auch die Si_3N_4 -Schicht möglichst rein hergestellt werden.

Bei den aus dem Stand der Technik bekannten Methoden zum Sintern der porösen, offenporigen, amorphen Solartiegel, wie z. B.
Ofensintern, Zonensintern, Sintern im Lichtbogen, Kontaktsintern, Sintern mit heißen Gasen oder mittels Plasma werden die
zu sinternden Solartiegel durch Übertragung von thermischer
Energie bzw. Wärmestrahlung erhitzt. Sollen die auf diesem Weg
herzustellenden Solartiegel eine extrem hohe Reinheit bezüglich
jeglicher Art von Fremdatomen aufweisen, so führt der Einsatz
von heißen Gasen oder heißen Kontaktflächen zu einer unerwünschten Kontamination mit Fremdatomen.

Beim Aufbringen der $\mathrm{Si}_3\mathrm{N}_4$ -Schicht mittels Plasmaverfahrens kommt es ebenfalls zu einer Übertragung von thermischer Energie mittels Wärmestrahlung. Auch dabei führt der Einsatz von heißen Gasen zu einer unerwünschten Kontamination mit Fremdatomen.

20 Ferner sind aus dem Stand der Technik aufwendige zweistufige Verfahren zur Herstellung von mit Si_3N_4 beschichteten Solartiegeln bekannt.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfahren zur Herstellung Si_3N_4 beschichteter SiO_2 -Formkörper bereit zu stellen, bei dem die Gefahr einer Kontamination sowohl der Si_3N_4 -Schicht als auch des SiO_2 -Formkörpers vermindert ist.

25

Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren, bei dem auf die 30 Oberfläche eines amorphen offenporigen SiO₂-Grünkörpers ein Präkursor, der zur Bildung einer Si₃N₄-Sinterschicht geeignet ist, aufgebracht wird und anschließend diese Oberfläche des SiO₂-Grünkörpers durch ein kontaktloses Erwärmen mittels eines Laserstrahls derart erhitzt wird, dass im Laserstrahl in situ eine Umwandlung des Präkursors in eine Si₃N₄-Sinterschicht erfolgt.

3

Prinzipiell sind alle Laser verwendbar, bevorzugt ist jedoch ein Laser mit einem Strahl einer Wellenlänge von 10,6 µm. Als Laser eignen sich insbesondere alle kommerziell erhältlichen CO₂-Laser.

5

10

15

20

25

30

35

Unter einem SiO₂-Grünkörper ist ein aus amorphen SiO₂-Partikeln (Kieselglas) durch Formgebungsschritte hergestellter poröser amorpher offenporiger Formkörper zu verstehen. Vorzugsweise ist der Grünkörper noch nicht einer Verfestigung mittels Temperaturbehandlung unterworfen worden.

SiO₂-Grünkörper sind aus dem Stand der Technik bekannt. Ihre Herstellung ist z. B. in den Patenten EP 705797, EP 318100, EP 653381, DE-OS 2218766, GB-B-2329893, JP 5294610, US-A-4,929,579 beschrieben. Besonders geeignet sind SiO₂-Grünkörper, deren Herstellung in DE-A1-19943103 beschrieben ist.

Als Präkursoren zur Bildung der Si_3N_4 -Schicht können alle Materialien verwendet werden, die nach Erhitzen eine Si_3N_4 -Sinterschicht ausbilden können. Solche Materialien sind beispielsweise Si_3N_4 -Pulver, Siliciumpulver, Siliciumoxid-Kohlenstoff-Gemische oder Polysilazane. Sofern es sich beim erfindungsgemäßen Formkörper um einen Solartiegel handelt, ist ein einseitiger Auftrag des Präkursors auf die innenseitige Oberfläche des SiO_2 -Grünkörpers bevorzugt.

Als Präkursor bevorzugt ist ein Si_3N_4 -Pulver. Es wird auf die Oberfläche des Grünkörpers aufgetragen, ggf. getrocknet und bildet durch die adsorbierte Energie des Laserstrahls eine Si_3N_4 -Sinterschicht.

Als $\mathrm{Si}_3\mathrm{N}_4$ -Pulver können alle handelsüblichen Pulver (z.B. der Firma H.C. Stark) verwendet werden. Vorzugsweise werden besonders feinkörnige $\mathrm{Si}_3\mathrm{N}_4$ -Pulver mit einer Körnung zwischen 100nm und 100µm, besonders bevorzugt zwischen 100nm und 50µm, und ganz besonders bevorzugt zwischen 100nm und 10µm, verwendet.

4

Das Si_3N_4 -Pulver kann nach allen dem Fachmann bekannten Methoden auf die Oberfläche des SiO_2 -Grünkörpers aufgetragen werden. Bevorzugt ist ein Besprühen der Oberfläche mit einer Si_3N_4 -Pulver-Dispersion. Als Dispergiermittel sind prinzipiell alle Lösemittel geeignet, bevorzugt sind Alkohole, Aceton und Wasser, besonders bevorzugt ist Wasser. Ferner können zur besseren Dispersion des Si_3N_4 -Pulvers auch alle dem Fachmann bekannten Zusätze verwendet werden, wie z. B. Dispergiermittel und Verflüssiger.

10

15

5

Wird das Si_3N_4 -Pulver als Dispersion aufgetragen, erfolgt nach dem Auftrag vorzugsweise eine Trocknung der Schicht. Das Trocknen erfolgt dabei mittels dem Fachmann bekannter Methoden wie z.B. Vakuumtrocknung, Trocknung mittels heißer Gase wie z.B. Stickstoff oder Luft oder Kontakttrocknung. Auch eine Kombination der einzelnen Trocknungsmethoden ist möglich. Bevorzugt ist eine Trocknung mittels heißer Gase.

Die so erhaltene $\mathrm{Si_3N_4}$ -Pulverschicht hat im Allgemeinen eine Schichtdicke von 1 bis 1000 μ m, bevorzugt eine Schichtdicke von 1 bis 500 μ m und besonders bevorzugt von 1 bis 100 μ m. Fig. 1 zeigt eine entsprechend beschichtete Oberfläche.

Um die Si₃N₄-Sinterschicht auszubilden und vorzugsweise gleichzeitig den Grünkörper durch eine Ansinterung zu verfestigen, wird der Grünkörper nach dem Auftrag des Präkursors von einem Laserstrahl mit einem Brennfleckdurchmesser von vorzugsweise mindestens 2 cm bestrahlt.

Die Bestrahlung erfolgt vorzugsweise mit einer Strahlungsleistungsdichte von 50W bis 500W pro Quadratzentimeter, besonders bevorzugt von 100 bis 200 und ganz besonders bevorzugt von 130 bis 180 W/cm². Die Leistung pro cm² muss zumindest so groß sein, dass eine Si₃N₄-Sinterschichtbildung erfolgt.

35

25

Die Si $_3N_4$ -Sinterschichtbildung erfolgt bevorzugt bei einer Temperatur zwischen 1000°C und 1600°C, besonders bevorzugt zwischen 1000°C und 1200°C.

20

Die Bestrahlung erfolgt vorzugsweise gleichmäßig und kontinuierlich.

Das gleichmäßige, kontinuierliche Bestrahlen des vorbehandelten SiO_2 -Grünkörpers lässt sich prinzipiell durch eine bewegliche Laseroptik und/oder einer entsprechenden Bewegung des Tiegels im Strahl des Lasers durchführen.

Die Bewegung des Laserstrahls lässt sich mit allen dem Fachmann bekannten Methoden durchführen, z.B. mittels eines Strahlführungssystems, das eine Bewegung des Laserfokus in alle Richtungen ermöglicht. Die Bewegung des Grünkörpers im Laserstrahl lässt sich ebenfalls mit allen dem Fachmann bekannten Methoden durchführen, z.B. mittels eines Roboters. Ferner ist eine Kombination beider Bewegungen möglich.

Bei größeren Formkörpern, z.B. Solartiegeln, ist ein Abrastern, d.h. ein kontinuierliches, flächendeckendes Verfahren der Probe unter dem Laserbrennfleck, bevorzugt.

Die Bildung der Si_3N_4 -Sinterschicht wird an jedem Ort über den Eintrag an Laserleistung gesteuert.

Bevorzugt ist eine möglichst gleichmäßige Bildung der Si₃N₄-25 Sinterschicht. Durch die Geometrie des SiO2-Grünkörpers bedingt, kann es sein, dass der Strahl des Lasers während der Bestrahlung des Grünkörpers nicht immer unter einem konstanten Winkel auf die Grünkörperoberfläche trifft. Da die Absorption 30 der Laserstrahlung winkelabhängig ist, ergibt sich dadurch eine ungleichmäßig dicke Si₃N₄-Sinterschicht. Eine gleichmäßige Si₃N₄-Sinterschicht wird dadurch erhalten, dass mit einer entsprechenden Brennflecktemperaturmessung zu jeder Zeit die Temperatur im Brennfleck des Lasers gemessen werden kann. Dabei wird ein Teil der reflektierenden Wärmestrahlung über ein spe-35 zielles Spiegelsystem auf ein Pyrometer übertragen, welches zur Temperaturmessung dient.

Durch Einbindung dieser Temperaturmessung in das Gesamtsystem Laser und bewegter Grünkörper können darüber hinaus eine oder mehrere der Prozessgrößen Laserleistung, Verfahrweg, Verfahrgeschwindigkeit und Laserfokus während der Laserbestrahlung des Grünkörpers so angepasst werden, dass eine gleichmäßige Si_3N_4 -Sinterschicht erzielt werden kann (Fig. 2 und 3).

6

Ferner ist bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wichtig, dass die SiO₂-Grünkörper eine poröse Struktur aufweisen und somit

10 Präkursoren leicht in den oberflächennahen Bereich des Grünkörpers infiltriert werden können. Dies ermöglicht die Ausbildung eines Silizium-Oxi-Nitrid-Interfaces zwischen SiO₂-Scherben und Si₃N₄-Sinterschicht.

15 Vorzugsweise kann die Si_3N_4 -Sinterschichtbildung während des gesamten Prozesses unter reduziertem Druck bzw. Vakuum durchgeführt werden.

20

25

35

Wird unter reduziertem Druck gearbeitet, liegt der Druck dabei unterhalb des Normaldrucks von 1013,25 mbar, besonders bevorzugt zwischen 0,01 und 100 mbar, ganz besonders bevorzugt zwischen 0,01 und 1 mbar. In einer besonderen Ausführungsform kann auch unter Vakuum ($< 10^{-3}$ mbar) gearbeitet werden, um absolut blasenfreie Schichten zu erzeugen.

Durch die punktuelle Verweildauer des Brennflecks lässt sich über die Si_3N_4 -Sinterschicht hinaus auch die Verfestigung des Grünkörpers bis hin zur vollständigen Verglasung steuern.

30 Dies geschieht durch Wärmeleitung von der heißen Körperoberfläche in den Formkörper hinein bei Temperaturen oberhalb von 1000°C.

Aufgrund der sehr geringen Wärmeleitfähigkeit des Kieselglases kann mit dem erfindungsgemäßen Verfahren eine sehr scharfe und definierte Grenzfläche zwischen verfestigten und unverfestigten Bereichen im SiO₂-Formkörper erzeugt werden. Dies führt zu SiO₂-Formkörpern mit einem definierten Sintergradienten.

WO 2005/026067

Darüber hinaus wird durch den extremen Temperaturverlauf im SiO_2 -Grünkörper während des Prozesses eine Kristallisation des Kieselglases unterdrückt.

5

Da sich bei einer innenseitigen Verfestigung eines Grünkörpers in Tiegelform kein Schrumpf der Tiegelaußenseite einstellt, können auf diese Weise einfach endkonturnahe Tiegel hergestellt werden.

10

Bei dem innenseitig mit einer Si_3N_4 -Sinterschicht versehenen angesinterten offenporigen SiO_2 -Formkörper handelt es sich vorzugsweise um einen Tiegel für die Kristallisation von Solarsilicium.

15

Fig. 1 zeigt eine REM-Aufnahme eines mit Si_3N_4 -Pulver beschichteten SiO_2 -Grünkörpers.

Fig. 2 zeigt eine REM-Aufnahme eines SiO_2 -Formkörpers mit einer Si_3N_4 -Sinterschicht nach Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens. Mit Pfeil markiert sind Punkte, an denen eine Sinterhalsbildung sichtbar ist.

Fig. 3 zeigt das Röntgendiffraktometer-Spektrum (RDA) eines SiO₂ Formkörpers mit einer Si $_3$ N $_4$ -Sinterschicht nach Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens.

Im Folgenden wird die Erfindung anhand von Beispielen näher beschrieben.

30

- Beispiel 1: Herstellung eines offenporigen porösen amorphen SiO_2 -Grünkörpers in Tiegelform
- Die Herstellung erfolgte in Anlehnung an das in US-A-2003-35 0104920 beschriebene Verfahren.

In einem 10 Liter Kunststoffbecher wurden 3800 g bidest. $\rm H_2O$ vorgelegt. Mit einem kunststoffbeschichteten Propellerrührer

wurden zunächst 712 g Fumed Silica, BET Oberfläche 200 m²/g, erhältlich unter der Bezeichnung Wacker HDK® bei der Firma Wacker-Chemie GmbH, München, in 30 min eingerührt. Anschließend wurden portionsweise in 30 min 8188 g Fused Silica, mittlere Teilchengröße 15 μ m, erhältlich unter der Bezeichnung Excelica® SE-15 bei der Firma Tokuyama zugegeben und dispergiert. Im Anschluss an die vollständige Dispergierung wurde die Dispersion 10 Minuten einem leichten Unterdruck (0,8 bar) unterzogen, um eventuelle eingeschlossene Luftblasen zu entfernen.

10

35

5

Die so hergestellte Dispersion bestand aus 8900 g Feststoff, was einem Feststoffgehalt von 70 Gew.% entspricht (davon wiederum 92% Fused Silica und 8% Fumed Silica).

- Die Herstellung des Grünkörpers erfolgte mittels keramischer Druckgusstechnik. Dazu wird die SiO2-Dispersion von einem Vorlagebehälter mit einem Druck von 10 bar durch ein Leitungssystem zwischen zwei offenporige Kunststoffmembranen aus Methylmethacrylat gepresst. Die Membranen weisen eine Porosität von
- 20 30 Vol.% und einen mittleren Porenradius von 20 μ m auf. Der Abstand der beiden Membranen zueinander lässt die Bildung eines 10 mm dicken Scherbens zu.
 - Die beiden Membrane werden mit einem Schließdruck von 200 bar beaufschlagt.
- Durch den Druck, der auf der Dispersion lastet, wird der größte Teil des Wassers der Dispersion in die Membrane gedrückt. Es bildet sich der SiO₂-Scherben.
- Nach Ablauf der Scherbenbildung von 45 min wird der Druck im Vorlagebehälter auf 0 bar Überdruck reduziert. Spezielle in der 30 Membrane verlegte Luft- und Wasserleitungen ermöglichen es, den gebildeten Formkörper durch die poröse Membrane mit Luft oder Wasser zur Endformung zu beaufschlagen. Dabei löst sich der Formkörper von der Membrane.
 - Zuerst wird der Formkörper von der äußeren Membrane gelöst, dann von der inneren.
 - Der so hergestellte amorphe offenporige poröse Formkörper weist einen Feststoffgehalt von 89 Gew.% und einem Restwassergehalt

9

von 11 Gew.% auf. Nach einer Trocknung bei 90°C für 3 Stunden ist der Formkörper vollständig getrocknet.

5 Beispiel 2: Innenseitige Beschichtung mit Si₃N₄-Pulver

172 g Si₃N₄-Pulver (der Firma H.C. Stark, D₅₀ Wert 4 μm) wurden in 50 g bidestilliertes Wasser mit Hilfe eines kunststoffbe-schichteten Propellerrührers dispergiert. Diese Dispersion wurde mit Hilfe einer handelsüblichen Lacksprühpistole gleichmäßig auf die Tiegelinnenseite aufgesprüht, bis sich eine 100μm dicke Schicht gebildet hatte. (siehe Fig. 1) Daran schloss sich eine einstündige Trocknung bei 90°C im Trockenschrank an.

15 Beispiel 3: Bildung der Si₃N₄-Sinterschicht mittels CO₂-Laser

Der Tiegel wurde mittels eines ABB-Roboters (Typ IRB 2400) im Fokus eines CO_2 -Lasers (Typ TLF 3000 Turbo) mit 3 kW Strahl-leistung bestrahlt.

20

25

30

35

Der Laser war mit einem starren Strahlführungssystem ausgestattet und alle Freiheitsgrade der Bewegung wurden vom Roboter bereitgestellt. Neben einem Umlenkspiegel, der die vom Laserresonator horizontal austretende Strahlung in die Vertikale umlenkt, war die Strahlführung mit einer Optik zum Aufweiten des Primärstrahls ausgestattet. Der Primärstrahl hatte einen Durchmesser von 16 mm. Nachdem der parallele Primärstrahl die Aufweiteoptik passiert hatte, ergab sich ein divergenter Strahlengang. Der Brennfleck auf dem Tiegel hatte einen Durchmesser von 50 mm bei einem Abstand von ca. 450 mm zwischen Optik und Tiegel. Der Roboter wurde über ein auf die Tiegelgeometrie angepasstes Programm gesteuert. Bei rotierendem Tiegel (Winkelgeschwindigkeit 0,15°/s) wurde zunächst der obere Rand des Tiegels vom Laser in einem Winkelbereich von 375° überstrichen. Dann wurde in Form einer Schraube der Rest der Innenfläche des Tiegels abgefahren. Rotationsgeschwindigkeit und Vorschubgeschwindigkeit des Tiegels auf einer Achse vom Tiegelrand zur

Mitte hin wurden hierbei so beschleunigt, dass die überstriche-

10

ne Fläche pro Zeit konstant war. Die Bestrahlung erfolgte mit 150 W/cm^2 .

Im gleichen Verfahrensschritt wurde neben der Bildung einer $\mathrm{Si}_3\mathrm{N}_4$ -Sinterschicht auf der Grünkörperoberfläche auch ein Ansintern des SiO_2 -Formkörpers durch Wärmeleitung von der heißen inneren Oberfläche in das Innere des Formkörpers erreicht. Nach der Laserbestrahlung ist der Tiegel unter Beibehaltung seiner ursprünglichen, äußeren Geometrie mit einer 100 μ m dicken, gleichmäßigen, festen $\mathrm{Si}_3\mathrm{N}_4$ -Sinterschicht flächendeckend bedeckt. (siehe Fig. 2)

10

WO 2005/026067

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Si₃N₄ beschichteten SiO₂-Formkörpers aus einem SiO₂-Grünkörper, dadurch gekennzeichnet, dass auf eine Oberfläche des amorphen offenporigen SiO₂-Grünkörpers ein Präkursor, der zur Bildung einer Si₃N₄-Sinterschicht geeignet ist, aufgebracht wird und anschließend im Laserstrahl in situ eine Umwandlung des Präkursors in eine Si₃N₄-Sinterschicht erfolgt.

10

5

- 2. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem Laserstrahl um den Strahl eines CO₂-Lasers handelt.
- 3. Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass es sich beim SiO₂-Formkörper um einen Solartiegel handelt, und der Auftrag des Präkursors einseitig auf die innenseitige Oberfläche des SiO₂-Grünkörpers erfolgt.
- 4. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Präkursor, der zur Bildung einer Si₃N₄-Sinterschicht geeignet ist, ausgewählt ist aus der Gruppe Si₃N₄-Pulver, Siliciumpulver, Siliciumoxid-Kohlenstoff-Gemische und Polysilazane.

25

- 5. Verfahren gemäß Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Präkursor ein Si_3N_4 -Pulver ist.
- 6. Verfahren gemäß Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Si $_3$ N $_4$ -Pulver eine Körnung zwischen 100nm und 100µm, bevorzugt zwischen 100nm und 50µm und besonders bevorzugt zwischen 100nm und 10µm, besitzt.
- 7. Verfahren gemäß Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Si₃N₄-Pulver in Form einer Si₃N₄-Pulver-Dispersion durch Besprühen der Oberfläche des SiO₂-Grünkörpers aufgebracht und anschließend getrocknet wird.

8. Verfahren gemäß Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Dispersion ein Dispergiermittel ausgewählt aus der Gruppe Alkohole, Aceton und Wasser umfasst.

12

- 9. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die auf der Oberfläche vorliegende Si₃N₄-Pulverschicht eine Schichtdicke von 1 bis 1000μm, bevorzugt von 1 bis 500μm, hat.
- 10. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der SiO2-Grünkörper nach dem Auftrag des Präkursors von einem Laserstrahl mit einem Brennfleckdurchmesser von mindestens 2 cm bestrahlt wird.
- 15 11. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Laserstrahl eine Strahlungsleistungsdichte von 50W bis 500W pro Quadratzentimeter, besonders bevorzugt von 100 bis 200 und ganz besonders bevorzugt von 130 bis 180 W/cm², besitzt.

20

25

- 12. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Si₃N₄-Sinterschichtbildung bei einer Temperatur zwischen 1000°C und 1600°C, besonders bevorzugt zwischen 1100°C und 1200°C, erfolgt.
- 13. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Bestrahlung gleichmäßig und kontinuierlich erfolgt.

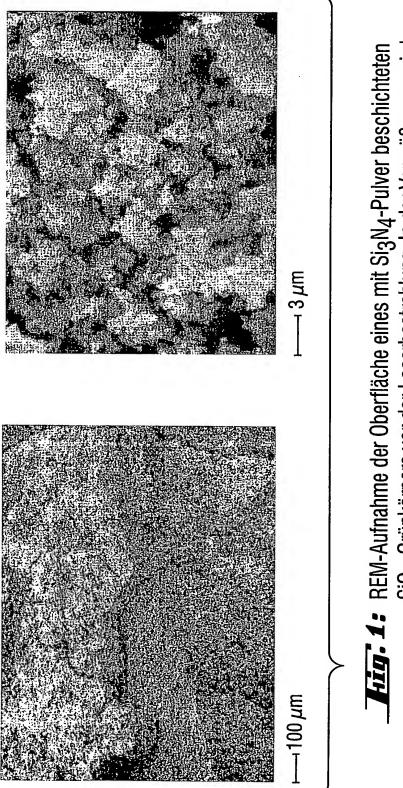


Fig. 1: REM-Aufnahme der Oberfläche eines mit Si₃N₄-Pulver beschichteten SiO₂-Grünkörpers vor der Laserbestrahlung. In der Vergrößerung wird die porige Struktur der Si₃N₄ Schicht deutlich.

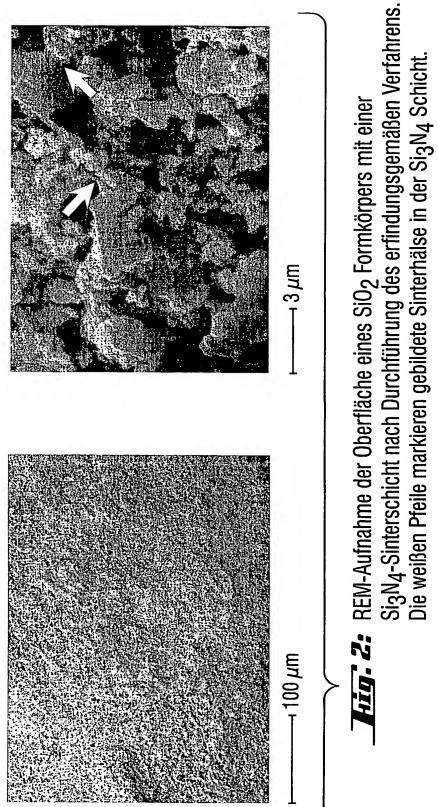
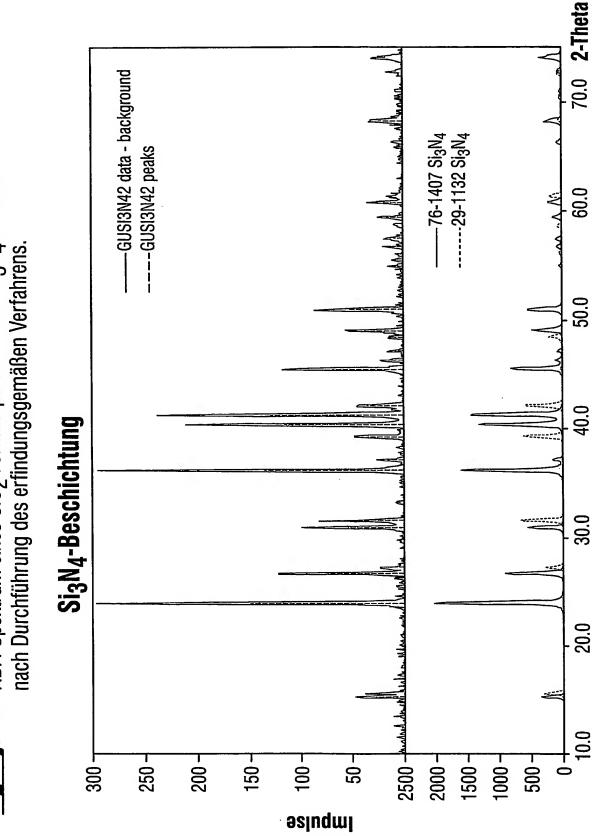


Fig. 3: RDA-Spektrum eines SiO₂ Formkörpers mit einer Si₃N₄-Sinterschicht



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PP/EP2004/009792

A. CLASSII IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER C03B20/00 C30B15/10		
According to	nternational Patent Classification (IPC) or to both national cla	escification and IDC	
	SEARCHED	BS/INCARIOTI ATIO IT O	
	cumentation searched (classification system followed by class C03B C30B	offication symbols)	
Documentat	ion searched other than minimum documentation to the extent	that such documents are included in the fields se	earched
Electronic da	ata base consulted during the international search (name of da	ata base and, where practical, search terms used)
EPO-In	ternal, WPI Data, PAJ, CHEM ABS [Data	
C. DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with Indication, where appropriate, of t	he relevant passages	Relevant to daim No.
Y	US 2003/104920 A1 (ENGLER SVEN 5 June 2003 (2003-06-05) cited in the application the whole document	N ET AL)	1–13
Υ	US 2003/001313 A1 (HEINRICH JL AL) 2 January 2003 (2003-01-02 das ganze Dokument, insbesonde 0026	1-13	
Α	WO 02/40182 A (G T EQUIPMENT TINC) 23 May 2002 (2002–05–23) the whole document	FECHNOLOGIES	1–13
			Į.
Furth	ner documents are listed in the continuation of box C.	χ Patent family members are listed i	л аппех.
° Special ca	tegories of cited documents :	*T* later document published after the inte	rnational filling data
consid	ent defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance	or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention	the application but earlying the
filing d "L" docume which	nt which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another	"X" document of particular relevance; the cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the do "Y" document of particular relevance; the	be considered to cument is taken alone
O docume other r		cannot be considered to involve an in document is combined with one or mo ments, such combination being obvior in the art.	ventive step when the ore other such docu-
P docume	ent published prior to the international filing date but an the priority date claimed	*&* document member of the same patent	family
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of the international sea	rch report
9	November 2004	16/11/2004	
Name and n	nailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Munro, B	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No Per/EP2004/009792

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 2003104920	A1	05-06-2003	DE CN FR JP	10158521 A1 1422819 A 2832705 A1 2003221246 A	26-06-2003 11-06-2003 30-05-2003 05-08-2003
US 2003001313	A1	02-01-2003	DE EP JP	10128664 A1 1266878 A1 2003048781 A	30-01-2003 18-12-2002 21-02-2003
WO 0240182	Α	23-05-2002	AU AU WO WO US US US	3067102 A 5154301 A 8856601 A 0240182 A1 0240732 A1 0240183 A1 2002146510 A1 2002086119 A1 2002076501 A1	27-05-2002 27-05-2002 27-05-2002 23-05-2002 23-05-2002 23-05-2002 10-10-2002 04-07-2002 20-06-2002

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen FCT/EP2004/009792

A. KLASSI IPK 7	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES C03B20/00 C30B15/10		
Nach der In	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas	sifikatlon und der IPK	
B. RECHE	RCHIERTE GEBIETE		
	rter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbol C03B C30B	le)	
	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, son		
Während de	er Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Na	ame der Datenbank und evtl. verwendete S	Suchbegriffe)
EPO-In	ternal, WPI Data, PAJ, CHEM ABS Data		A.
C. ALS WE	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	US 2003/104920 A1 (ENGLER SVEN E 5. Juni 2003 (2003-06-05) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument	1–13	
Y	US 2003/001313 A1 (HEINRICH JURGE AL) 2. Januar 2003 (2003-01-02) das ganze Dokument, insbesondere 0026	1–13	
А	WO 02/40182 A (G T EQUIPMENT TECH INC) 23. Mai 2002 (2002-05-23) das ganze Dokument 	NOLOGIES	1–13
	itere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu nehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	
"A" Veröffe aber i "E" älteres Anme "L" Veröffe scheil ander soll of ausge "O" Veröffe dem i	entlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen sidedatum veröffentlicht worden ist entlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zwelfelhaft ernen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer ren im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie efführt) entlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht anglichung, die ver dem Internationalen. Anmeldedatum aber nach	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht Anmeldung nicht kollidiert, sondern nu Erfindung zugrundellegenden Prinzips Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedet kann allein aufgrund dieser Veröffentlicher Frügkeit beruhend betre "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedet kann nicht als auf erfinderischer Tätigk werden, wenn die Veröffentlichung mit Veröffentlichung mit veröffentlichungen dieser Kategorie in diese Verbindung für einen Fachmann "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Absendedatum des internationalen Re	t worden ist und mit der r zum Verständnis des der oder der ihr zugrundellegenden utung; die beanspruchte Erfindung chung nicht als neu oder auf achtet werden utung; die beanspruchte Erfindung weit beruhend betrachtet einer oder mehreren anderen Verbindung gebracht wird und naheliegend ist
9	O. November 2004	16/11/2004	
Name und	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (431–70) 340–3016	Bevollmächtigter Bediensteter Munro, B	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen	
F7/EP2004/009792	

Im Recherchenbe angeführtes Patentdo		Datum der - Veröffentlichung	-	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 2003104	920 A1	05-06-2003	DE CN FR JP	10158521 A1 1422819 A 2832705 A1 2003221246 A	26-06-2003 11-06-2003 30-05-2003 05-08-2003
US 2003001	313 A1	02-01-2003	DE EP JP	10128664 A1 1266878 A1 2003048781 A	30-01-2003 18-12-2002 21-02-2003
WO 0240182	A	23-05-2002	AU AU WO WO US US US	3067102 A 5154301 A 8856601 A 0240182 A1 0240732 A1 0240183 A1 2002146510 A1 2002086119 A1 2002076501 A1	27-05-2002 27-05-2002 27-05-2002 23-05-2002 23-05-2002 23-05-2002 10-10-2002 04-07-2002 20-06-2002